

烟台德邦科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,556.00万股，每股发行价格46.12元，募集资金总额为164,002.72万元，扣除不含税发行费用152,543,951.12元后，本公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。

募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币135,894,306.56元后的募集资金为人民币1,504,132,893.44元，已由主承销商东方证券股份有限公司于2022年9月14日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为535902385410508的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第210029号《验资报告》予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

项 目	金 额（元）	说 明
募集资金到账验资金额	1,504,132,893.44	
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用	7,283,018.76	
支付发行费用	9,366,625.80	
募集资金净额	1,487,483,248.88	
减：募投项目投入	669,850,641.60	
超募部分永久补充流动资金	553,530,000.00	
加：扣除手续费后利息收入和理财收益	47,713,051.76	

项目	金额（元）	说明
保函保证金退回	730,000.00	
使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额	125,000,000.00	
截止 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	187,545,659.04	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议，明确了各方的权利和义务，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金专用账户的存储情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额(元)	备注
招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410968	14,286.28	
招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410266	36,641,014.64	
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410906	536,519.60	
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410508	381,488.88	
招商银行股份有限公司昆山支行	512910748910966	1,174.23	
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	1265600000901666	11,775,485.77	
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100862080	97,844.73	
中国光大银行烟台经济技术开发区支行	38080188000258467	3,215,200.53	
中信银行股份有限公司烟台自贸区支行	8110601011601495861	46,636.84	
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	12656000000931613	9,804,238.11	
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410616	66,245,890.43	
中国光大银行股份有限公司烟台九隆支行	38090188000191019	7,055,426.37	

开户银行	账号	募集资金余额(元)	备注
招商银行股份有限公司烟台分行	535904836910706	51,730,452.63	
合计	/	187,545,659.04	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

本公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间根据实际需要使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品等方式支付募投项目所涉部分款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

报告期内，本公司使用票据等支付募投项目金额为 41,770,682.00 元，截止报告期末，41,770,682.00 元票据支付募投项目金额已全部完成置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 90,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

机构名称	产品名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	收
------	------	------	-----	-----	---------	---

						益
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	人民币单位结构性存款 2510560	100,000,000.00	2025/06/06	2025/09/04	1%/2.11%/2.32%	保本浮动收益
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	人民币单位结构性存款 2510558	25,000,000.00	2025/06/06	2025/07/07	1%/2.13%/2.34%	
合 计	/	125,000,000.00	/	/	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司分别于 2023 年 10 月 18 日和 2024 年 10 月 16 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 25,300.00 万元和 4,920.00 万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）用于归还银行贷款和永久补充流动资金。

公司 2025 年半年度共计使用超募资金永久补充流动资金 14,753.00 万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

烟台德邦科技股份有限公司

2025 年 8 月 16 日

募集资金使用情况对照表

2025 年度半年度

编制单位：烟台德邦科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		148,748.32				本年度投入募集资金总额		26,987.53		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		122,338.06		
累计变更用途的募集资金总额		4,924.49								
累计变更用途的募集资金总额比例		3.31%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高端电子专用材料生产项目	否	38,733.48	38,733.48	525.88	38,439.15	99.24	2023年12月	28,952.99	不适用	否
年产35吨半导体电子封装材料建设项目	是	11,166.48	6,241.99	-	5.00	0.08	2026年9月	不适用	不适用	否
新建研发中心建设项目	是	14,479.23	17,690.85	1,579.79	4,000.30	22.61	2026年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		64,379.19	62,666.32	2,105.67	42,444.46	67.73		28,952.99		
超募资金投向										
超募资金永久补流	否		55,305.80	14,753.00	55,353.00	100.09	不适用	不适用	不适用	否

新能源及电子信息封装材料建设项目	否		30,776.20	10,128.85	24,540.61	79.74	2027年2月	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		-	86,082.00	24,881.85	79,893.61	92.81				
合计		64,379.19	148,748.32	26,987.53	122,338.06	82.25		28,952.99		
项目可行性发生重大变化的情况说明							无			
募集资金投资项目实施地点变更情况							无			
募集资金投资项目实施方式调整情况							无			
募集资金投资项目先期投入及置换情况							详见本专项报告三、（二）			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因							无			
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							详见本专项报告三、（四）			
超募资金的金额、用途及使用进展情况							无			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况							无			

注 1：高端电子专用材料生产项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额；

注 2：年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目募集资金拟投资金额由 11,166.48 万元变更为 6,241.99 万元，调减募集资金拟投资金额 4,924.49 万元，其中 3,211.62 万元拟用于新建研发中心建设项目的追加投资，剩余部分 1,712.87 万元及相关利息、理财收益继续留存于募集资金专户；

注 3：新建研发中心建设项目募集资金拟投资金额由 14,479.23 万元变更为 17,690.85 万元，调增募集资金拟投资金额 3,211.62 万元，调增资金来源于年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目调减的募集资金拟投资金额。